

Zukünftige HDI-Leiterplatten mit Feinstleiterzügen und Mehrfach-Microvia-lagen



Zukünftige Bauelemente mit hohen Anschlusszahlen benötigen zur optimalen Entflechtung Mehrfach-Microvia-lagen und Feinstleiter. Zur Herstellung von Mehrfach-Microvia-lagen-Boards wird eine im Vergleich zum total sequentiellen Aufbau kostengünstige semisequentielle Aufbautechnik beschrieben, die von prüfbareren Teilaufbauten ausgeht. Mit Hilfe der Lasertechnik werden in den Strukturierungsprozessen höhere Registriergenauigkeiten und eine bessere Auflösung erreicht. // State-of-art components with large number of interconnection pins require multilayer microvia boards and fine-gauge track, to optimise packaging design. The production of multilayer microvia boards is described, using a semi-sequential build-up technique, which can be more cost-effective than a totally sequential production method. The new method allows testing at intermediate stages. Using laser equipment, the patterning process can be carried out with improved registration and a higher resolution.

Bewertung: Noch nicht bewertet